

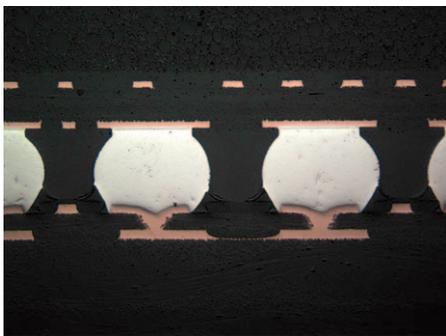
鉛フリー対応 Lead Free

# 一般用 ソルダペースト

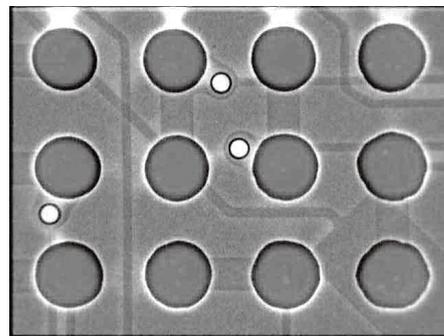
## Solder Paste for General Use

### LFSOLDER TLF-204-MDS Series

#### 優れたBGAのぬれ性を実現! An Excellent Wettability for BGA!



良好なBGAのぬれ性  
An excellent wettability for BGA



ボイド占有率0.6%  
Void occupancy rate 0.6%

#### 特長

- 連続印刷時の経時変化が少なく、安定した印刷性が得られます。
- ボイドの低減に非常に効果的です。
- チップ脇ボールの低減に効果的です。
- プリヒートだれ性の向上に効果的です。
- 鉛フリーに適合した高温プロファイルにおいても優れたはんだ付け性を示します。
- 0.4mmピッチ BGA等のぬれに関しても良好なはんだ付け性を示します。
- 0.4mmピッチ CSP等微小パターンにおいても良好なはんだ付け性が得られます。(TLF-204-MDSII)
- LGAボイドの低減に非常に効果的です。(TLF-204-MDSIII)

#### FEATURES

- Stable printability is obtained with little change in viscosity during continuous printing.
- Void seldom occurs.
- Reduces mid-chip solder balls.
- Does not slump in pre-heat.
- Excellent solderability at high temperature.
- Excellent solderability for 0.4mm pitch BGA.
- Excellent solderability can be attained at small pattern of 0.4mm pitch CSP. (TLF-204-MDS II)
- Reduces void formation of LGA. (TLF-204-MDS III)

#### BGAぬれ試験結果 Non-fusion examination of BGA

品名	TLF-204-MDS	TLF-204-MDSII	TLF-204-MDSIII
BGAぬれ発生数* Non-fusion of BGA*	7/676	6/676	6/676

\*酸化処理 To be oxidized:85°C / 85% / 24h

#### TLF-204-MDSシリーズの特性比較 General Properties

項目	ITEM	TLF-204-MDS	TLF-204-MDS II	TLF-204-MDS III
合金組成	Alloy Composition	Sn/3.0Ag/0.5Cu	Sn/3.0Ag/0.5Cu	Sn/3.0Ag/0.5Cu
融点	Melting Point (°C)	216~220	216~220	216~220
はんだ粉末の粒度	Particle Size of Solder Powder (μm)	25~41	20~36	25~41
フラックス含有量	Flux Content (%)	10.9	11.0	11.0
塩素含有量	Chlorine Content (%)	0.0	0.0	0.0
粘度	Viscosity (Pa·s)	195	195	195
チクソトロピー指数	Thixotropy Index	0.55	0.57	0.55



問い合わせ先

株式会社タムラ製作所 電子機材営業部

〒358-8501 埼玉県入間市狭山ヶ原16-2 TEL 04 (2934) 6131 FAX 04 (2934) 6559